

はんだ・微細接合部会 シンポジウム ～DX・GX 時代を支える実装技術・材料の研究開発動向～

開催日：2024年7月23日（火）

開催場所：溶接会館2階ホール及びオンライン開催

主 催
一般社団法人 日本溶接協会

企 画
はんだ・微細接合部会 技術委員会 微細接合技術分科会

協 賛
一般社団法人 エレクトロニクス実装学会
一般社団法人 スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会
一般社団法人 日本溶接協会 マイクロソルダリング要員認証委員会

後 援
一般社団法人 電子情報技術産業協会
(依頼中含む)

[開催趣旨]

デジタルトランスフォーメーション（DX）およびグリーントランスフォーメーション（GX）時代において、エレクトロニクス機器は社会の基盤としてますます重要な役割を果たすようになっています。デジタル化が進む中で、データ処理の速度と効率が重視され、同時にエネルギー消費の削減と環境への配慮も急務となっています。そうした中で進化が求められる先端ロジック半導体やパワー半導体においては、実装技術と材料の重要性も一層強く認識されています。

そこで今回のシンポジウムでは、これらのDX・GX時代を支える半導体デバイスとそこに用いられる実装技術・材料の研究開発動向についてご講演いただきます。また今回新たに、当はんだ・微細接合部会員の企業様からの新技術・製品紹介と、関連する洗浄性評価WGの規格化活動の取り組みをご紹介いただきます。

皆様のご参加を心からお待ち申し上げております。

【プログラム】

Part1:

座長：大阪大学 巽 裕章 氏

13:00-13:05 開会挨拶 はんだ・微細接合部会
部会長 赤池 信一 氏 (株)タムラ製作所

13:05-13:55 「チップレット集積の現状と課題」

NEP Tech. S&S, ニシダエレクトロニクス実装技術支援 西田 秀行 氏

13:55-14:45 「パワー半導体のパッケージ技術」

富士電機(株) 両角 朗 氏

14:45-14:55

休憩

Part2: はんだ関連材料・機器 技術紹介

座長：群馬大学 小林 竜也 氏

14:55-15:55

「市場用途に応じた接合材料の紹介」 (株)タムラ製作所

「低温ソルダーリング材料」 千住金属工業(株)

「低温はんだペースト」 (株)日本スペリア社

「はんだこての進化」 白光(株)

「ウィルヘルミー法と画像解析との複合によるぬれ性計測」 (株)レスカ

15:55-16:05

休憩

Part3: 洗浄性評価 WG 活動報告 & 洗浄関連材料・機器 技術紹介

座長：群馬大学 小林 竜也 氏

16:05-17:05

「国際規格 (ISO9455-18) 取り組み紹介」 群馬工業高等専門学校 山内 啓 氏

「フラックス洗浄における評価手法/付加価値」 ゼストロンジャパン(株)

「最近のフラックス洗浄の課題に対する取組」 花王(株)

「フラックス洗浄の課題と対応する洗浄技術」 化研テック(株)

17:05-17:10 閉会挨拶 群馬大学 小林 竜也 氏

・講師およびスケジュールについては、やむを得ない事情により変更になる場合があります。

【開催要領】

1. 日 時

2024年7月23日（火）13:00～17:00

2. 場 所

日本溶接協会 溶接会館2階ホールおよびオンライン(WEB)開催

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町4-20 及び Zoom webinar

3. 定員（定員になり次第、締切となります）

溶接会館での参加：70名

オンラインでの参加：100名

4. 参加費

会員 10,000円

非会員 15,000円

※上記料金は参加者1名分となります。料金にはテキスト代（PDF）・消費税を含みます。

※会員とは、日本溶接協会 本部団体会員（<http://www-it.jwes.or.jp/kain/kaindsp.jsp>）
およびマイクロソルダリング資格保持者です。

※協賛団体会員は、日本溶接協会会員に準拠します。

5. 申込締切日

2024年7月8日（水）（定員になり次第、締切となります）

6. 申込要領等

(1) お申込は下記URLからお願いいたします。

<https://www-it.jwes.or.jp/seminar/>

（右記QRコードからもお申込可能です。）



(2) 入力いただいた個人情報は「個人情報保護に関する法律」に則り当協会が定めた個人情報保護方針に従い管理します。詳細は「一般社団法人 日本溶接協会 個人情報保護方針」（<http://www.jwes.or.jp/privacy.html#info>）をご参照下さい。

(3) 参加費は以下の口座へお振込み下さい。

三井住友銀行 神田駅前支店 普通預金口座 No.146921（一社）日本溶接協会

（原則として銀行口座への振込をもって領収に代えさせていただきます。）

銀行振込手数料は各自ご負担下さい。

請求書ご希望の場合は、申込時に摘要欄にご記載下さい。

(4) お振込後の参加費は返金いたしません。ご欠席の場合は、代理出席をお願いいたします。
（シンポジウムが中止となった場合のみ費用は全額返金致します）

(5) 開催1週間前までにメールにてテキストPDFダウンロードのご案内をお送りします。
未着の場合は事務局までご連絡下さい。

※お申込みから当日までの流れ【溶接会館へお越しの方】

①受講確定メールには、【受講番号】が明記されております。受付の際受講番号で出席確認しますので、印刷またはスマートフォンでの画面をご提示下さい。

②新型コロナウイルスが感染症法上の5類へ移行するのに伴い、当分科会は新型コロナウイルス感染防止のためのガイドラインを見直し、簡易の体調確認書を提出いただくことになりました（別紙）。

※お申込みから当日までの流れ【オンライン参加の方】

①受付手続完了後に当協会よりお送りする受講確定メールに【受講番号】が記載されております。下記登録の際に必要となります。

②オンライン事前登録完了後、オンラインシンポジウム参加用 URLをお送りいたします。

※参加用 URLはご登録者様専用のため、他の人の共有はできません。

※シンポジウム開催の1週間前までに事前登録用 URLがお手元に届かない場合は、事務局までご連絡下さい。

③オンラインシンポジウム当日、シンポジウム開始時間15分前までに②の URLにアクセスいただき、ご参加下さい。

※別途、詳しい手順をご案内いたします。

【注意事項】

◆インターネット経由でのライブ配信ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があります。また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合がありますが、あらかじめご了承下さい。

◆本オンラインシンポジウムはお申し込みいただいた方のみ受講いただけます。複数端末から同時に視聴することや複数人での視聴は禁止させていただきます。

◆本オンラインシンポジウムの配信（撮影・録音・録画・スクリーンショットの取得その他一切の手段による）および講演内容の無断転用・転載は法律に基づき、固く禁止させていただきます。

◆その他やむを得ない事由により、講師による講演は別会場から講演となる可能性または、シンポジウムが中止となる場合がございます。

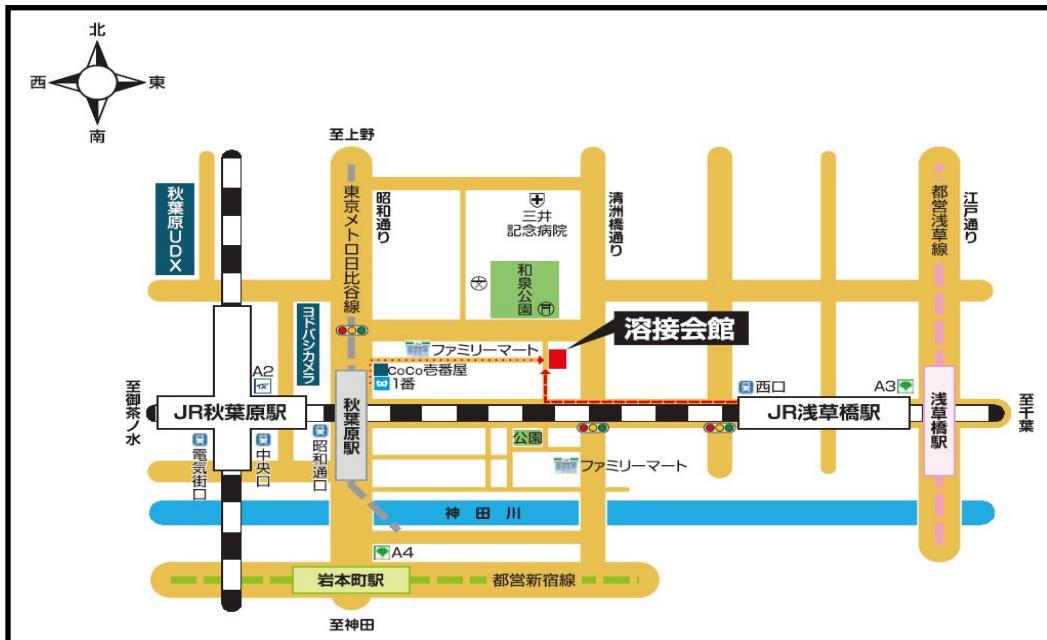
7. 事務局（連絡先）

一般社団法人日本溶接協会 業務部 今岡

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町4-20 TEL: 03-5823-6324 FAX: 03-5823-5244

8. 会場

日本溶接協会 溶接会館 2階ホール 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町4-20



【交通案内】

JR秋葉原駅 昭和通りから徒歩8分 / JR浅草橋駅 西口から徒歩8分

東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 1番出口より徒歩7分

都営新宿線 岩本町駅 A4出口より徒歩12分 / 都営浅草線 浅草橋駅 A3出口より徒歩11分